

## AI社会のキーテクノロジー『光電融合と光回路実装技術』

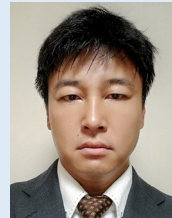
近年、AI需要の急拡大に伴い、高速データ通信や半導体実装のさらなる高集積化を実現するため、革新的な技術の開発が求められています。そこで、今回はキーテクノロジーである光電融合技術や光回路実装技術に関して最先端の研究開発動向を講演いただきます。新たな技術開発のヒントやビジネスのきっかけとなれば幸いです。多数のご参加をお待ちしております。

- ・日時 : 2026年3月27日(金) 12時50分～17時00分
- ・場所 : 大阪公立大学 I-Siteなんば C2+C3室  
<https://www.omu.ac.jp/isite/access/>  
**現地開催のみ 定員 : 100名(先着申込順)**
- ・主催 : 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 関西支部
- ・協賛 : エレクトロニクス実装学会光回路実装技術委員会・研究会

I-siteなんば  
アクセス

## プログラム

- ・12:50-13:00 開会の挨拶
- ・13:00-13:55 基調講演  
「2025年度光回路実装技術ロードマップの全体概要とCPOの進化」  
三菱電機 大畠 伸夫 氏  
本講演では、バックエンドネットワークの現状と今後のトレンドについて述べる。さらに、光回路実装技術研究会で調査、議論を進めて来たCPOの進化についても言及する。
- ・14:00-14:30 技術講演1  
「Co-Packaged Optics(CPO)の技術動向と今後の展望」  
パナソニック インダストリー 山口 敦史 氏  
本講演では、バックエンドネットワークのScale-outネットワークに焦点を当て、スイッチASICの進化と次世代204.8 Tb/sスイッチASICのCPO仕様を示す。また、光回路実装におけるCPOの位置づけと今後の展望について述べる。
- ・14:35-15:05 技術講演2  
「電気ICと基板材料技術の進展と課題」  
新光電気工業 古田 裕司 氏  
AI/MLの進展により、データセンターでは高速化と省電力化が求められている。本講演では、光電融合技術における電気IC、基板材料、パッケージングの最新動向と課題を紹介する。
- ・15:05-15:20 休憩
- ・15:20-15:50 技術講演3  
「自己形成光導波路による多チャネル光ファイバの簡易低損失接続」  
Orbray 行川 毅 氏  
多チャネル光接続・実装には、従来より高精度なアライメント技術が必要である。本講演では、アライメント緩和効果が期待できる自己形成光導波路を用いた多チャネル光ファイバ間の簡易低損失接続について報告する。
- ・15:55-16:25 技術講演4  
「光電集積モジュール設計におけるシミュレーション技術」  
京セラ 上野 涼 氏  
高速大容量通信を低消費電力で実現すべく電気信号を光信号に変換する『光電集積モジュール』の開発を進めています。本講演ではモジュール設計における光学・熱・構造のシミュレーション事例を紹介する。
- ・16:30-17:00 技術講演5  
「光電融合を見据えた次世代半導体パッケージ向け樹脂材料の開発」  
味の素 唐川 成弘 氏  
弊社では光電コパッケージ向けの絶縁材料の開発を行っている。本講演ではポリマー導波路向けの材料紹介と作製した導波路の挙動について報告する。
- ・17:00-17:05 閉会の挨拶・終了



◆定員 100名（先着申込順）

◆参加費（税込、名刺交換会費込、資料配布なし）

会員／賛助会員／協賛学会会員：10,000円

シニア会員：5,000円 一般：14,000円

学生会員：1,000円 一般学生：2,000円

※賛助会員クーポン利用不可

【名刺交換会】

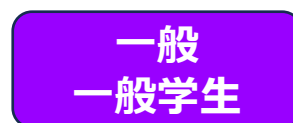
開催時間：17時30分～19:00予定

場所：I-siteなんば A1・A2

申込締切：2026年3月3日（火）

【参加申込】

※名刺交換会参加希望者は、**【名刺交換会参加】**を選択ください。



【決済方法・支払期限】

クレジットカード、コンビニ決済

学会会員のみ：銀行振込(バーチャル口座：手数料をご負担ください)

請求書・領収書発行：申込登録完了メールのマイページURL⇒ログイン

⇒決済タブ⇒PDFダウンロード（宛名選択可能です）

支払期限：2026年3月25日（水）

【協賛会員】（予定）

日本電子回路工業会（JPCA）、表面技術協会関西支部、応用物理学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部、日本接着学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会、近畿化学協会エレクトロニクス部会、日本繊維機械学会、化学工学会エレクトロニクス部会、大阪府立大学ものづくりイノベーション研究所、電子情報通信学会、電子部品・材料研究専門委員会、日本セラミックス協会関西支部、電気化学会関西支部



問い合わせ先：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

お問合せMail：E-mail: info@jiep.or.jp

ホームページ: <https://jiep.or.jp>

